

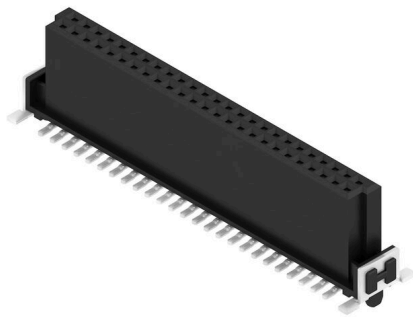
FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder
Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten
Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontakt-Koplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, 180°, Tape
Best.-Nr.	2747400000
Art	FFH9 S1/50V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000914
VPE	280 ST
Produkt-Kennzahlen	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Verpackung	Tape

FFH9 S1/50V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus)	E92202

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7.8 mm	Tiefe (inch)	0.3071 inch
Höhe	9.9 mm	Höhe (inch)	0.3898 inch
Breite	36.83 mm	Breite (inch)	1.45 inch
Nettogewicht	7.43 g		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	Keine SVHC über 0,1 Gew.-%

Systemkennwerte

Übertragungsrate	3,125 Gbit/s	Produktfamilie	OMNIMATE Signal - Board-to-Board
Anschlussart	Platinenanschluss	Montage auf der Leiterplatte	SMD-Lötanschluss
Raster in mm (P)	1.27 mm	Raster in Zoll (P)	0.050 "
Abgangswinkel	180°	Polzahl	50
Anzahl Lötstifte pro Pol	1	Koplanarität	0.1 mm
Anzahl Reihen	1	Polreihenanzahl	2
Schutzart	IP20	Durchgangswiderstand	<25 mΩ
Steckzyklen	500	Steckkraft/Pol, max.	0.6 N
Ziehkraft/Pol, max.	0.6 N		

Werkstoffdaten

Isolierstoff	LCP	Farbe	schwarz
Farbtabelle (ähnlich)	RAL 9011	Isolierstoffgruppe	Illa
Isolationswiderstand	≥ 10 ¹⁰ Ω	Moisture Level (MSL)	1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0	Kontaktbasismaterial	Kupferlegierung
Kontaktmaterial	Cu-leg	Kontaktoberfläche	Gold über Nickel
Schichtaufbau - Steckkontakt	≥ 2 µm Ni / ≥ 0.4 µm PdNi / ≥ 0.05 µm Au	Lagertemperatur, min.	-40 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Betriebstemperatur, min.	-55 °C
Betriebstemperatur, max.	125 °C		

Bemessungsdaten nach IEC

Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C)	2.8 A	Kriechstrecke, min.	0.4 mm
Luftstrecke, min.	0.4 mm		

Nennwerten nach UL 1977

Hinweis zu den Zulassungswerten	Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.	Bemessungsspannung (UL 1977) (veraltet)	150 V
---------------------------------	---	---	-------

Technische Daten**Verpackungen**

Verpackung	Tape	VPE Länge	350.00 mm
VPE Breite	340.00 mm	VPE Höhe	135.00 mm

Wichtiger Hinweis

IPC-Konformität	Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
-----------------	--

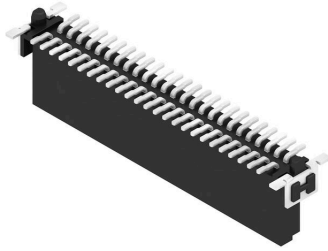
Hinweise

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

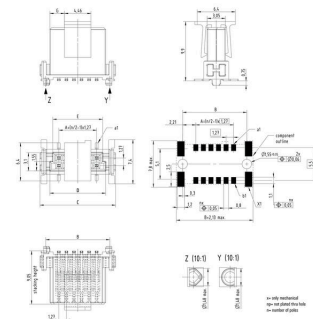
Zeichnungen

Produktbild



Maßbild

Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E	G
FFH9 S1/27V F1 B RL	2347140000	12	45,26	82,11	82,2	82,2	82,2	2,48
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347260000	18	6,89	13,21	15,24	17,91	18,81	3,73
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347300000	24	11,43	19,85	17,78	14,40	13,40	5
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347330000	28	16,24	18,65	21,59	18,25	17,25	3,84
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347380000	31	18,8	23,4	24	23,01	21,81	4,81
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347390000	40	28,13	28,16	30,43	27,15	28,15	11,51
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347400000	50	30,48	34,29	30,81	33,5	33,5	11,78
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347410000	60	41,91	46,51	46,26	44,61	43,61	20,74
FFH9 S1/30V F1 B RL	2347420000	60	48,52	53,86	55,88	52,55	51,55	24,91



Detailzeichnung



Deratingkurve



Zeichnungen



FMH – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH S1/50H F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	2747220000	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675000990	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, 90°, Tape
VPE	560 ST	

FMH1 – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 1,75 mm)



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

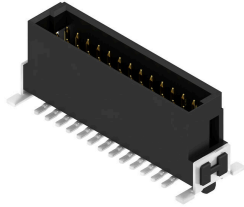
Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH1 S1/50V F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	2747040000	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675001065	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, 180°, Tape
VPE	280 ST	

FMH3 – Stiftleiste, Leiterplattenanschluss (Bauhöhe 3,25 mm)



OMNIMATE® - Board-to-Board-Steckverbinder

Flexible Konstruktion von Kompaktgeräten

Der Einsatz zukunftssicherer Kontaktsysteme sowie die Optimierung von Fertigungsprozessen werden bei der Entwicklung effizienter Industriegeräte, insbesondere in der Industry 4.0, immer wichtiger. OMNIMATE® Board-to-Board-Steckverbinder besitzen ein 1,27-mm-Raster und bieten dank unterschiedlicher Ausführungen maximale Flexibilität.

- Flexible Gerätekonstruktion - Industrietaugliche Packungsdichte gepaart mit hochflexiblen Verbindungskombinationen (Mezzanine, Mother-to-Daughter, Erweiterungskarte, Cable-to-Board)
- Automation-Ready - Entwickelt für die Automatenbestückung mit hochpräziser Kontaktkoplanarität und SMT-Fixierung
- Zuverlässiger Kontakt - Bis zu 500 Steckzyklen durch industrietaugliche Goldoberfläche (PdNi-Au)
- Process-Ready - Hochleistungsfähiges LCP-Material für Reflow-Löten
- Skalierbarkeit - Unterschiedliche Höhen mit hoher Kontaktüberlappung gewährleisten unterschiedliche Lösungen mit 12–80 Polen.
- Robuste Miniaturisierung - einfache und sichere Verbindung auch bei ungünstigen Steckbedingungen – z. B. Schrägstellung oder Versatz.

Allgemeine Bestelldaten

Art	FMH3 S1/50V F1 B RL	Ausführung
Best.-Nr.	2747130000	Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, SMD-Lötanschluss, Raster in
GTIN (EAN)	4064675001461	mm (P): 1.27 mm, Polzahl: 50, 180°, Tape
VPE	280 ST	